

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A beépített sínbusz a modulok elektronika házrendszerhez**

Amikor modulok alkalmazásokon belül táplál, csatlakoztat vagy eloszt, a sínbusz helyettesítheti az időrabló egyéni huzalozás folyamatát a rugalmas és az egész rendszerben folyamatos megoldással.

A rendszerbusz biztonságosan be van építve a 35 mm-es szabványos szerelősínbe. Az SMD busz kapocstömbjét reflow forrasztani lehet, így teljesen automatizált módon feldolgozható az alkatrész beültetés során. Az ellenálló, aranyozott érintkező felületek biztosítják a tartós és megbízható csatlakozást az összes szekrény szélességben.

- **Korlátlan méretezhetőség** A beépített csatlakozási megoldás lefedi az összes rendszer szélességet: A 6 mm-es szelettől a 67 mm nagyterületű házig.
- **A felszerelés közben könnyen szervizelhető** Egy modult könnyen ki lehet cserélni, még a meglévő modulcsoportokban – is, a szomszédos modulokra gyakorolt minden hatás nélkül.
- **Univerzális beépítés** A megszakítatlan rendszerbusz biztonságosan be van építve a 35 mm-es szabványos szerelősínbe.
- **A legnagyobb rendelkezésre állás** Öt, teljesen galvanizált és részben aranyozott kettős ívű érintkezőt használunk a sínbusz tartós csatlakoztatására. A THR forrasztható peremes aljzatok biztosítják, hogy a csatlakozás az áramköri laphoz stabil legyen.

Általános rendelési adatok

Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Busz-csatlakozóblokk CH20M6-hoz, THT/THR-forrasztott csatlakozással, Pólusszám: 5, 180°, Aranyozott, fekete
Rendelési szám	1155840000
Típus	SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX
GTIN (EAN)	4032248942534
Qty.	78 Stück
Termékadatok	IEC: 160 V UL: 300 V / 5 A
Csomagolás	Doboz

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	5,9 mm	Magasság (coll)	0,232 inch
Szélesség	16,3 mm	Szélesség (coll)	0,642 inch
Hossz	24 mm	Hossz, inch	0,945 inch
Nettó tömeg	2,897 g		


Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	LCP	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	IIIa
Kűszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	175 ≤ CTI <400	Szigetelés erőssége	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Érintkező felület	Aranyozott
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-30 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984	Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	3,6 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	160 V	Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	100 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	63 V	Rövid idejű határáram ellenállás	3 x 1s with 14.5 A
Névleges lökfeszültség a II/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	1,5 kV	Hézag, min.	2,3 mm
Kűszóút, min.	3,2 mm		

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus)		Tanúsítvány száma (cURus)	E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059)	300 V	Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059)	50 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059)	50 V	Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)	5 A
Névleges áram (C felhasználási csoport / UL 1059)	5 A	Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)	5 A
Hivatkozás a tanúsítási értékekre	A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.		

Anyagadatok

Kűszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	175 ≤ CTI <400	Szigetelőanyag	LCP
Szigetelőanyag csoport	IIIa		

Általános adatok

Szín	fekete	Színskála (hasonló)	RAL 9011
Védelmi osztály	IP20		

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9,1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-18-27-92

Fontos megjegyzés

IPC megfelelés

A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E60693

Letöltések

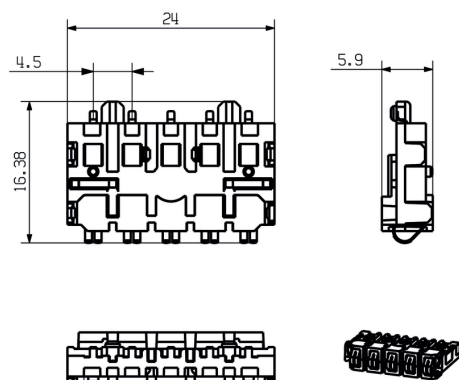
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

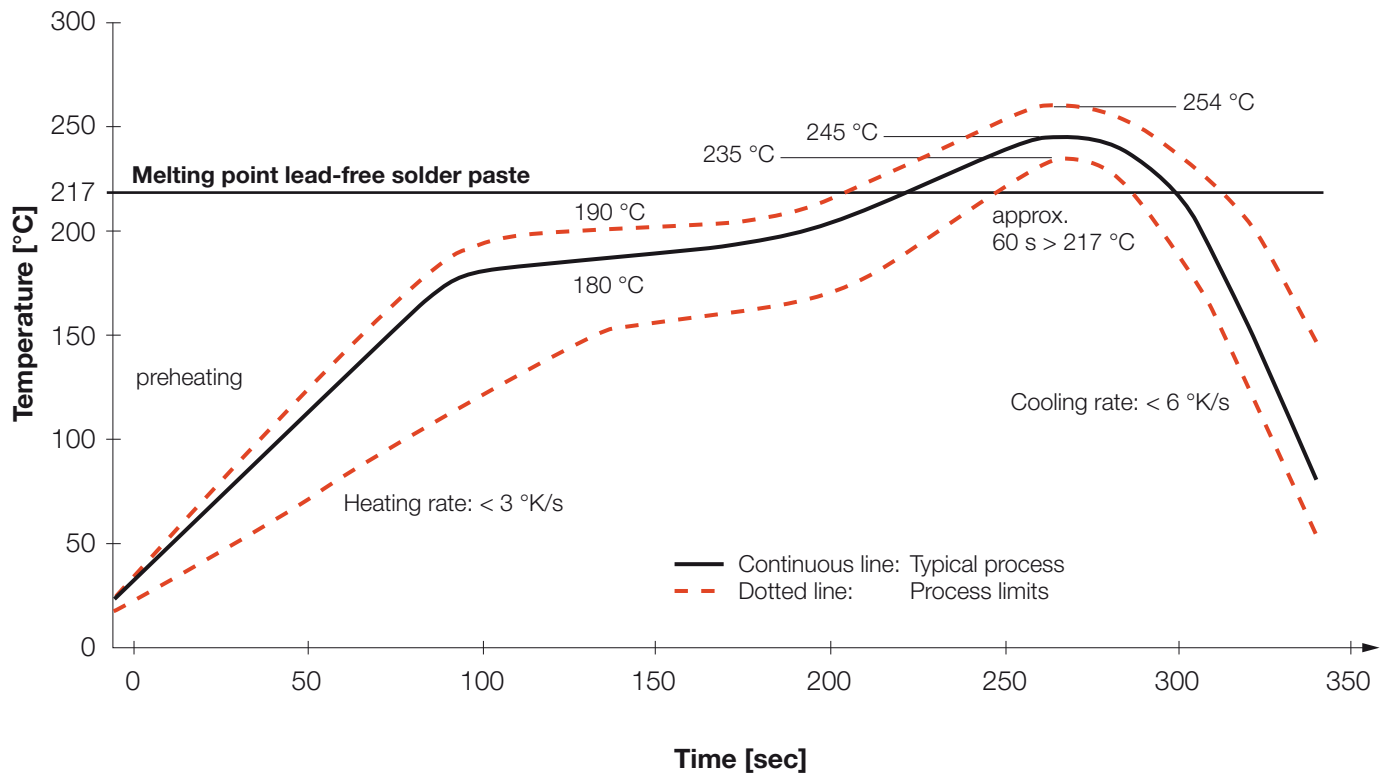
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.